

大瑞有铅/无铅锡球

DARUI HAS LEAD/LEAD-FREE TIN BALLS



产品参数

PRODUCT PARAMETERS



名称	大瑞有铅/无铅锡球	数量	25万颗/瓶
特点	高真圆度、高纯度与高单精度之成分控制 无静电,一球径表面无缺陷.		
用途	用于电脑主板维修,各种PCB生产,芯片生产 焊接等		

	有铅		有铅	
规格	成分	熔点	成分	熔点
0.2mm	63/37	180℃	96.5/3/0.5	221℃
0.25mm	63/37	180℃	96.5/3/0.5	221℃
0.3mm	63/37	180℃	96.5/3/0.5	221℃
0.35mm	63/37	180℃	96.5/3/0.5	221℃
0.4mm	63/37	180℃	96.5/3/0.5	221℃
0.45mm	63/37	180℃	96.5/3/0.5	221℃
0.5mm	63/37	180℃	96.5/3/0.5	221℃
0.55mm	63/37	180℃	96.5/3/0.5	221℃
0.6mm	63/37	180℃	96.5/3/0.5	221℃
0.65mm	63/37	180℃	96.5/3/0.5	221℃
0.76mm	63/37	180℃	96.5/3/0.5	221℃

25万颗锡球/瓶



产品用途

PRODUCT USE

